



公益社団法人 砥粒加工学会
砥粒加工工具を考える専門委員会 第5回研究会のご案内
「複合加工技術の最前線 -複合化による加工特性の向上-」

2017年6月、砥粒加工技術の発展のために(公社)砥粒加工学会「砥粒加工工具を考える専門委員会」が設立されました。本専門委員会では、工作物に直接関与する砥粒加工工具について新規開発、問題解決等に関する調査、討論を取り込んでおります。第5回研究会では【複合加工技術の最前線】と題して開催いたします。4名の講師の方々に複合加工技術について紹介していただきます。

日時：2018年9月21日(金) 13:00~17:35

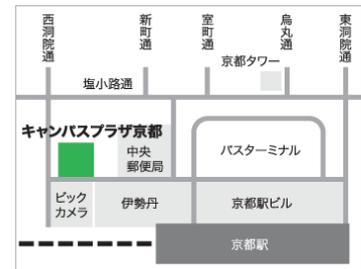
開催場所：キャンパスプラザ京都(6F第1講習室)

〒600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町939

(キャンパスプラザ京都施設受付窓口 TEL 075-353-9111)

<http://www.consortium.or.jp/about-cp-kyoto/access>

京都市営地下鉄烏丸線、近鉄京都線、JR「京都駅」下車。徒歩5分



内容：

- 13:00~13:10 開会挨拶 立命館大学 谷 泰弘
- 13:10~14:10 「プラズマ援用研磨によるワイドギャップ半導体のダメージフリー研磨」 大阪大学 山村 和也 氏
- 14:10~15:10 「紫外光を援用した研磨プロセスの開発」 熊本大学 久保田 章亀 氏
- 15:10~15:30 休憩
- 15:30~16:30 「光と極限の夢の実現と三百年企業」 ナルックス株式会社 大割 寛 氏
- 16:30~17:30 「高能率研削におけるナノバブル発生装置の効果と最新加工事例」 株式会社岡本工作機械製作所 土屋 恵児 氏
- 17:30~17:35 閉会挨拶・事務連絡

研究会参加費：10,000円。(本専門委員会の賛助会員は3名まで無料です。)

参加申込締切：平成30年9月13日(月)，定員(先着30名)に達した時点で締め切らせていただきます。

申込・問合せ先：立命館大学 張 宇

E-mail: zhangyu@fc.ritsumeai.ac.jp

Tel/Fax: 077-561-5055

公益社団法人砥粒加工学会 砥粒加工工具を考える専門委員会 第5回研究会参加申込書

氏名		
勤務先		
連絡先	住所	
	E-mail	
	Tel / Fax	